

ニュースガイドNo, 10830

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

\*最新の特許情報が満載！

## 無電解貴金属メッキ方法と工程

[公開編]平成24年(1年間) 70点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,000-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,000-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥31,500-	¥30,000-

### 既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10700	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.23	59点	¥18,000
No,10579	"	"	平.22	59点	¥18,000
No,10493B	"	"	平.21	60点	¥18,000
No,10493A	"	"	平.20	60点	¥18,000
No,10201B	"	"	平.19	66点	¥23,100
No,10201A	"	"	平.18	66点	¥23,100
No,9997C	"	"	平.17	84点	¥18,600
No,9997B	"	"	平.16	65点	¥19,200
No,9997A	"	"	平.15	62点	¥18,300
No,9520	"	"	平.13-平.14	84点	¥16,800
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-平.9	65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-平.19	62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-平.17	100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-平.12	68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12	71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-平.12	70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-平.12	71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-平.11	81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-平.11	75点	¥29,700
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-平.12	68点	¥24,700

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: [kokusai@itdc-patent.com](mailto:kokusai@itdc-patent.com))

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

### お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入	
所属部署名	題名	
	合計 ¥	
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所: 〒		

料金には別途送料がかかります。

# 無電解貴金属メッキ方法と工程

No. 10830

[公開編] 平成24年(1年間) 70点

CD-ROM版 ¥21,000 B5製本版 ¥21,000 (全て税込価格)

( CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥31,500 )

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| 1 無電解パラジウムめっき浴及び無電解パラジウムめっき方法  | 上村工業株式会社                               | 28 無電解めっきのための安定なナノ粒子  | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. |
| 2 複合粒子の製造方法  | JSR株式会社                                | 29 LED用ウエハ  | 株式会社高松メッキ                              |
| 3 無電解めっき前処理剤及びフレキシブル基板用銅張り積層体  | JX日鉱日石金属株式会社                           | 30 成形回路部品の製造方法  | 株式会社関東学院大学表面工学研究所                      |
| 4 白金成形物の表面硬化方法及び表面が硬化された白金成形物  | 株式会社フルヤ金属                              | 31 導電性粉体、それを含む導電性材料及びその製造方法                                 | 日本化学工業株式会社                             |
| 5 無電解金めっき液及び無電解金めっき方法  | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社             | 32 シリコン又はシリコン系材料を含む構造化された粒子の製造方法                            | ネグゼオン・リミテッド                            |
| 6 被覆体及び電子部品  | TDK株式会社                                | 33 アルミニウム - ダイヤモンド系複合体及びその製造方法                              | 電気化学工業株式会社                             |
| 7 アルミニウム酸化皮膜用除去液及びアルミニウム又はアルミニウム合金の表面処理方法  | 上村工業株式会社                               | 34 無電解白金めっき液、及び白金めっき製品の製造方法                                 | 独立行政法人産業技術総合研究所                        |
| 8 無電解めっき方法及びLED実装用基板   | 上村工業株式会社                               | 35 無電解メッキ法  | 下関鍍金株式会社                               |
| 9 非導通性金属光沢めっき膜を有する樹脂製品の製造方法、及び非導通性金属光沢めっき膜を有する樹脂製品無電解めっき法により金属膜を形成するための下地塗料、めっき下地用塗膜層の製造方法、めっき物の製造方法 | 日立マクセル株式会社                             | 36 銅又は銅合金板へのAg-Snめっき方法及びその方法により製造されたAg-Snめっきが施された銅或...      | 三菱伸銅株式会社                               |
| 10 加飾膜層と金属膜層を備えた樹脂シートの製造方法   | アキレス株式会社                               | 37 めっき触媒及び方法  | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. |
| 11 置換金めっき液及び接合部の形成方法   | 株式会社サカイヤ                               | 38 成形回路部品の製造方法  | 三共化成株式会社                               |
| 12 無電解めっきの前処理方法  | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社             | 39 基板構造物及びその製造方法  | サムソン エレクトロ - メカニックス カンパニーリミテッド.        |
| 13 ナノ粒子の組成物  | 奥野製薬工業株式会社                             | 40 金属パターンの製造方法  | コニカミルタI株式会社                            |
| 14 多孔質材料の無電解めっき方法  | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル.エル.シー. | 41 金属パターンの製造方法  | コニカミルタI株式会社                            |
| 15 誘電体基材表面の触媒フリー金属化方法及び金属膜付き誘電体基材  | 独立行政法人国立高等専門学校機構                       | 42 化学パラジウム / 金めっき皮膜構造及びその製造方法、銅線またはパラジウム / 銅線で接合されたパラジウム... | 台湾上村股 分 有限公司                           |
| 16 電子部品及びその製造方法  | 国立大学法人大阪大学                             | 43 金属メッキ材料の製造方法   | 国立大学法人福井大学                             |
| 17 水溶性物質を包含するカプセル状粒子の無電解めっき方法および無電解めっきされたカプセル状粒子   | 株式会社村田製作所                              | 44 銀鏡用第二活性処理液およびこれを用いた銀薄膜形成方法                               | 三菱製紙株式会社                               |
| 18 無電解めっき方法  | トヨタ自動車株式会社                             | 45 導電粒子、絶縁被覆導電粒子及びその製造方法、異方導電性接着剤                           | 日立化成工業株式会社                             |
| 19 無電解めっき方法  | 東亜合成株式会社                               | 46 無電解メッキパターン形成用組成物、塗布液、及び無電解メッキパターン形成方法                    | 東海旅客鉄道株式会社                             |
| 20 無電解めっき方法  | 凸版印刷株式会社                               | 47 基板中間体、基板及び貫通ビア電極形成方法                                     | 学校法人 関西大学                              |
| 21 金属パターンの形成方法   | 大和電機工業株式会社                             | 48 めっき装置およびめっき方法  | 住友ベークライト株式会社                           |
| 22 還元型無電解銀めっき液   | 上村工業株式会社                               | 49 無電解めっき装置、無電解めっき方法および配線回路基板の製造方法                          | 日東電工株式会社                               |
| 23 無電解メッキ金属被覆樹脂材料の製造方法、及び異方性導電接着剤  | ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社              | 50 高分子繊維材料のめっき方法及び高分子繊維材料の製造方法並びに被めっき用高分子繊維材料               | 名古屋メッキ工業株式会社                           |
| 24 複合めっき被膜の形成方法  | アイテック株式会社                              | 51 繊維材料の表面処理用筒状器具及びこれを用いた繊維材料の表面処理方法                        | 名古屋メッキ工業株式会社                           |
| 25 磁性担体の製造方法   | 日立マクセル株式会社                             | 52 めっき下地塗膜層   | アキレス株式会社                               |
| 26 無電解めっき液ろ過機制御装置  | 株式会社ニコン                                | 53 無電解めっき装置、無電解めっき方法および配線回路基板の製造方法                          | 日東電工株式会社                               |
| 27 無電解金属メッキの前処理剤およびこれを用いた回路基板の製造方法   | サムソン エレクトロ - メカニックス カンパニーリミテッド.        |   |  |

以下17点省略